京セラ株式会社

2027 年 3 月期 第 2 四半期決算説明会

2026 年 11 月 2 日

イベント概要

[企業名]	京セラ株式会社
[企業 ID]	6971
[イベント言語]	JPN
[イベント種類]	決算説明会
[イベント名]	2027 年 3 月期 第 2 四半期決算説明会
[決算期]	2027 年度　第 2 四半期
[日程]	2026 年 11 月 2 日
[時間]	16:00 – 16:46 （合計：46 分、登壇：16 分、質疑応答：30 分）
[開催場所]	インターネット配信
[登壇者]	2 名 代表取締役社長兼執行役員社長 最高経営責任者 作島　史朗（以下、作島） 取締役 執行役員常務 最高財務責任者 経営企画室担当兼コーポレート担当 千田　浩章（以下、千田）

登壇

司会：皆様、こんにちは。
お時間となりましたので、ただいまより、京セラ株式会社 2027 年 3 月期上期決算説明会を開催いたします。本日はお忙しい中ご参加いただき、誠にありがとうございます。

本日使用いたします資料は、当社ホームページに掲載しております。なお、本日のウェビナーは録画しております。あらかじめご了承ください。

それでは初めに、本日の出席者を紹介いたします。

代表取締役社長兼執行役員社長最高経営責任者 作島史朗でございます。

取締役執行役員常務 経営企画室担当兼コーポレート担当 最高財務責任者 千田浩章でございます。

それでは、社長の作島より決算の内容についてご説明いたします。作島社長、お願いいたします。



作島：いつも大変お世話になっております。社長の作島です。それでは、2027.3 期の上期決算についてご説明いたします。よろしくお願いいたします。



初めに、今回決算のハイライトをお伝えいたします。

まずは 2027.3 期の上期実績です。当上期は、主に AI データセンター向け部品の増収が一時損失の影響を上回ったことにより、増収増益となりました。

売上高は前年同期に比べ 8.8%増加の 1 兆 783 億円となり、上期として過去最高を更新しました。営業利益は 56.4%増加の 656 億円、利益率 6.1%、税引前利益は 36.9%増加の 930 億円、利益率 8.6%、親会社の所有者に帰属する中間利益は 32.2%増加の 734 億円、利益率 6.8%となりました。

コアコンポーネント及び電子部品は、主に AI データセンター向けに高付加価値の半導体パッケージやコンデンサ等の旺盛な需要が継続したことにより、増収増益となりました。

ソリューションは、前 4Q における米国機械工具子会社の譲渡に伴う売上減の影響はあったものの、この影響を除いた場合には増収増益となりました。

なお、当上期には一時損失約 341 億円を計上しました。電子部品における不動産売却収入等がプラス約 30 億円、その他の事業における GaN デバイス事業の減損損失がマイナス約 295 億円、ソリューションのその他におけるエネルギー関連製品に係る引当金のマイナス約 76 億円が、その内訳となります。GaN デバイス事業の減損損失計上については、後ほどご説明いたします。

また、平均為替レートは、対米ドル、ユーロともに前年同期に比べ円安となったことにより、売上高は約 630 億円、税引前利益は約 120 億円押し上げられました。これらの為替のプラス影響を除いた実質的な比較においても、前年同期に比べ増収増益となりました。



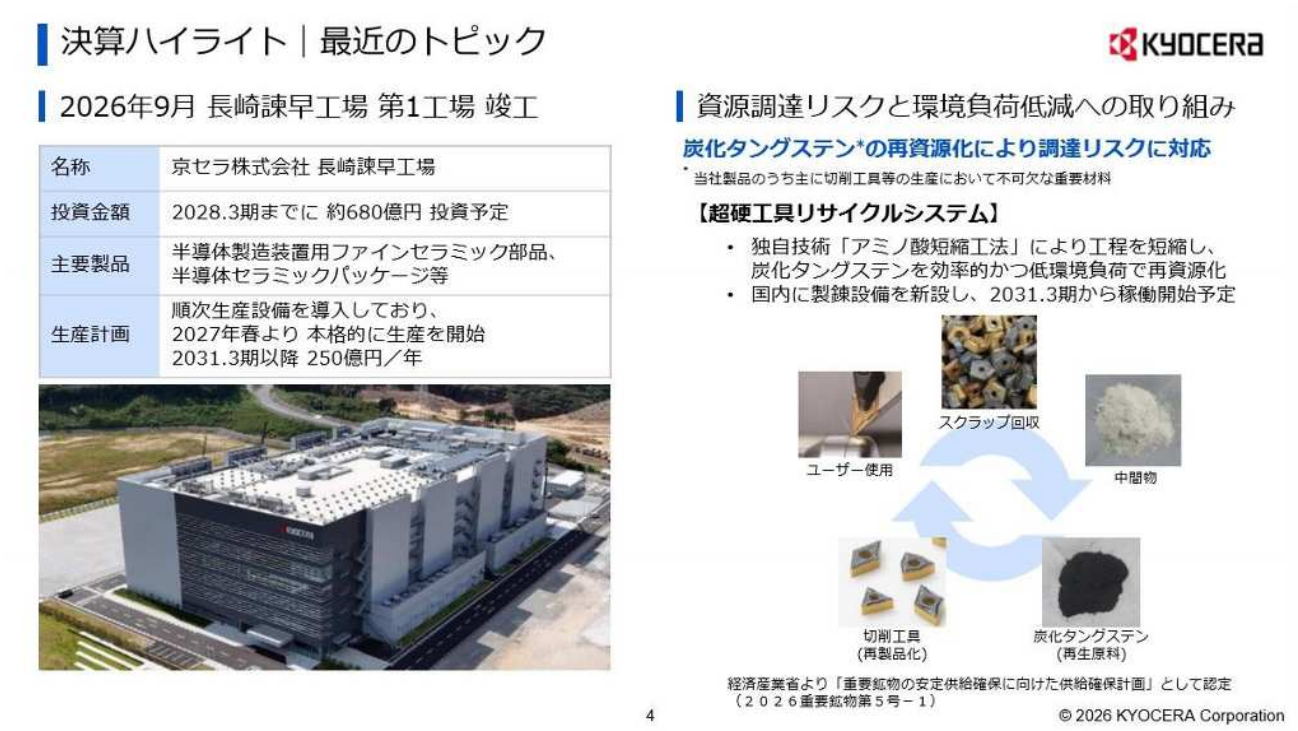
続いて、通期業績予想についてご説明いたします。旺盛な部品需要を主因に、売上高予想を上方修正するとともに、各事業の大幅な増益効果により、一時損失の影響をカバーする見通しです。

売上高は前回予想に比べ 400 億円増加の 2 兆 1,200 億円の予想としており、通期でも過去最高を更新する計画です。営業利益は 1,600 億円、利益率 7.5%、税引前利益は 2,000 億円、利益率 9.4%、親会社の所有者に帰属する当期利益は 1,600 億円、利益率 7.5%の予想とし、利益については 7 月公表予想から変更はありません。

当上期は、AI 及び半導体関連市場向け部品の需要拡大により想定を上回る実績であったこと、また、これらの製品については当 3Q 以降も堅調な需要が見込まれることから、本年 7 月公表予想から売上高は上方修正しています。

利益については、各事業での大幅な増益見通しに加え、ケミカル事業の譲渡益計上により、上期の一時損失の影響を補い、各利益は本年 7 月公表予想から据え置きの予想としています。

なお、通期平均為替レートの予想も本年 7 月公表予想からの変更はなく、為替の影響を除いた実質的な比較においても、前期比で増収増益の見通しです。



続いて、最近のトピックについてご説明いたします。

スライド左側をご覧ください。本年 9 月に、2024 年 9 月より建設を進めてきた長崎県諫早市の新工場内に、第 1 工場建屋が竣工いたしました。2028 年 3 月期までに約 680 億円を投資する予定であり、注力事業である半導体製造装置用ファインセラミック部品や半導体セラミックパッケージ等を中心に、順次生産設備を導入しており、2027 年春に本格的な生産を開始予定です。2031.3 期以降は年間約 250 億円の生産を計画しております。

スライド右側は、資源調達リスクと環境負荷低減への取り組みです。昨今、レアメタルやレアアースの安定供給が懸念されており、材料調達の主要な課題となっています。当社は、当社製品のうち主に切削工具等の生産において不可欠な重要材料である炭化タングステンの再資源化に取り組み、調達リスクに対応してまいります。

当社の独自技術、アミノ酸短縮工法により工程を短縮し、炭化タングステンを効率的かつ低環境負荷で再資源化することが可能となります。今後、国内に製錬設備を新設し、2031.3 月期から稼働を開始する予定です。

なお、本件は経済産業省より、重要鉱物の安定供給確保に向けた供給確保計画として認定を受けております。

2027.3期 上期 実績(1)

KYOCERA

（単位：百万円 /（ ）内の数字は売上高比率）

		2026.3期 上期	2027.3期 上期	増減 金額	増減 率
売上高		991,385	**1,078,337**	86,952	8.8%
営業利益		41,945 (4.2%)	**65,609** (6.1%)	23,664	56.4%
税引前利益		67,950 (6.9%)	**93,020** (8.6%)	25,070	36.9%
親会社の所有者に帰属する中間利益		55,540 (5.6%)	**73,430** (6.8%)	17,890	32.2%
平均為替レート	米ドル	146円	**159円**		
	ユーロ	168円	**184円**		
設備投資		88,740 (9.0%)	**81,897** (7.6%)	-6,843	-7.7%
有形固定資産 減価償却費		54,590 (5.5%)	**56,154** (5.2%)	1,564	2.9%
研究開発費		57,178 (5.8%)	**57,184** (5.3%)	6	0.0%

7

© 2026 KYOCERA Corporation

続いて、当上期の実績についてご説明いたします。当上期の業績は、先ほどご説明したとおり増収増益となりました。

表下段をご覧ください。設備投資は前年同期に比べ 7.7%減少の 819 億円、減価償却費は 2.9%増加の 562 億円、研究開発費は前年同期とほぼ横ばいの 572 億円となりました。

2027.3期 上期 実績(2)

KYOCERA

一時損益の内訳

	2026.3期 上期	2027.3期 上期	増減金額 (前期比における影響額)
①シリコンダイオード・パワー半導体事業の譲渡に伴う損失（電子部品）	約△21億円	-	約+21億円
②不動産売却収入等（電子部品）	-	約+30億円	約+30億円
③GaNデバイス事業 減損損失（その他の事業）	-	約△295億円	約△295億円
④エネルギー関連製品に係る引当金 （ソリューション）	-	約△76億円	約△76億円
営業利益及び税引前利益に含まれる一時損益　合計	**約△21億円**	**約△341億円**	**約△320億円**
親会社の所有者に帰属する中間利益に含まれる一時損益 合計 （上表の一時損益に関する税効果考慮後の金額）	**約△15億円**	**約△313億円**	**約△298億円**

GaNデバイス事業 減損損失計上について

減損対象資産	2021年1月 米国のGaN製レーザー製品の開発会社を買収した際に計上したのれん及び一部の無形資産
減損理由	主に車載部品や電子機器において当事業の開発品が実用化されることを目指し、事業化を推進していたものの、当初想定よりも収益化までの期間が長期化する見通しとなったことから、事業計画を見直した結果、対象資産の回収可能性が困難と判断したため
今後の展開	当該製品の実用化・収益化に向けて組織体制及び事業基盤を強化した上で事業活動を継続

8

© 2026 KYOCERA Corporation

こちらのスライドには、前上期および当上期に計上した一時損益を記載しています。

上段は、営業利益及び税引前利益に含まれる一時損益です。前上期には、シリコンダイオード・パワー半導体事業の譲渡に伴う損失約 21 億円を計上しました。一方、当上期は、一時的な利益として不動産売却収入約 30 億円、損失として GaN デバイス事業における減損損失約 295 億円及びエネルギー関連製品に係る引当金約 76 億円を計上しており、ネットで約マイナス 341 億円となります。

スライド下部には、GaN デバイス事業の減損損失計上について記載しております。

減損対象の資産は、2021 年 1 月に米国の GaN 製レーザー製品の開発会社を買収した際に計上した、のれん及び一部の無形資産です。

当事業は、主に車載部品や電子機器において当事業の開発品が実用化されることを目指し、事業化を推進していたものの、当初想定よりも収益化までの期間が長期化する見通しとなったことから、事業計画を見直した結果、対象資産の回収が困難と判断し、当上期において減損損失を計上することにしました。

今後については、当該製品の実用化、収益化に向けて組織体制および事業基盤を強化した上で、事業活動を継続してまいります。

2027.3期 上期 セグメント別売上高

KYOCERA

(単位：百万円)

	2026.3期 上期		2027.3期 上期		増減	
	金額	構成比	**金額**	**構成比**	金額	率
コアコンポーネント	307,658	31.0%	**368,173**	**34.1%**	60,515	19.7%
産業・車載用部品	118,895	12.0%	134,073	12.4%	15,178	12.8%
半導体関連部品	177,309	17.9%	221,144	20.5%	43,835	24.7%
その他	11,454	1.1%	12,956	1.2%	1,502	13.1%
電子部品	174,709	17.6%	**215,282**	**20.0%**	40,573	23.2%
ソリューション	519,021	52.4%	**503,784**	**46.7%**	-15,237	-2.9%
機械工具	156,983	15.8%	106,815	9.9%	-50,168	-32.0%
ドキュメントソリューション	220,920	22.3%	248,186	23.0%	27,266	12.3%
コミュニケーション	98,815	10.0%	106,898	9.9%	8,083	8.2%
その他	42,303	4.3%	41,885	3.9%	-418	-1.0%
その他の事業	6,623	0.7%	7,575	0.7%	952	14.4%
調整及び消去	-16,626	-1.7%	-16,477	-1.5%	149	—
売上高	991,385	100.0%	**1,078,337**	**100.0%**	86,952	8.8%

9

© 2026 KYOCERA Corporation

こちらはセグメント別売上高の一覧です。

2027.3期 上期 セグメント別利益

KYOCERA

(単位：百万円)

	2026.3期 上期		2027.3期 上期		増減	
	金額	売上高比	**金額**	**売上高比**	金額	率
コアコンポーネント	30,020	9.8%	**50,473**	**13.7%**	20,453	68.1%
産業・車載用部品	11,960	10.1%	19,209	14.3%	7,249	60.6%
半導体関連部品	19,115	10.8%	31,480	14.2%	12,365	64.7%
その他	-1,055	—	-216	—	839	—
電子部品	17	0.0%	**19,598**	**9.1%**	19,581	—
ソリューション	37,762	7.3%	**56,999**	**11.3%**	19,237	50.9%
機械工具	10,284	6.6%	19,164	17.9%	8,880	86.3%
ドキュメントソリューション	18,124	8.2%	29,634	11.9%	11,510	63.5%
コミュニケーション	4,200	4.3%	7,891	7.4%	3,691	87.9%
その他	5,154	12.2%	310※1	0.7%	-4,844	-94.0%
その他の事業	-12,061	—	-43,589※2	—	-31,528	—
事業利益　計	55,738	5.6%	**83,481**	**7.7%**	27,743	49.8%
本社部門損益等	12,212	—	9,539	—	-2,673	-21.9%
税引前利益	67,950	6.9%	**93,020**	**8.6%**	25,070	36.9%

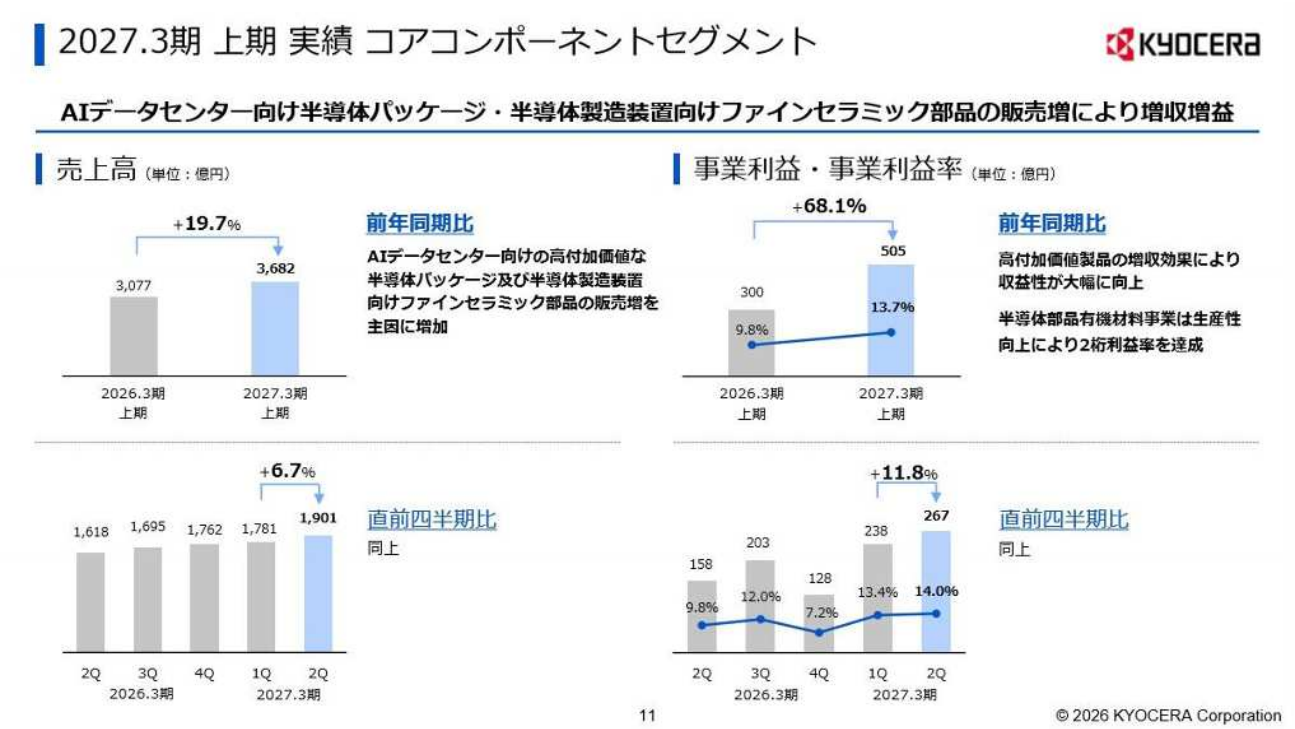
※1 エネルギー関連製品に係る引当金 約△76億円を含む。
※2 GaNデバイス事業 減損損失 約△295億円を含む。

10

© 2026 KYOCERA Corporation

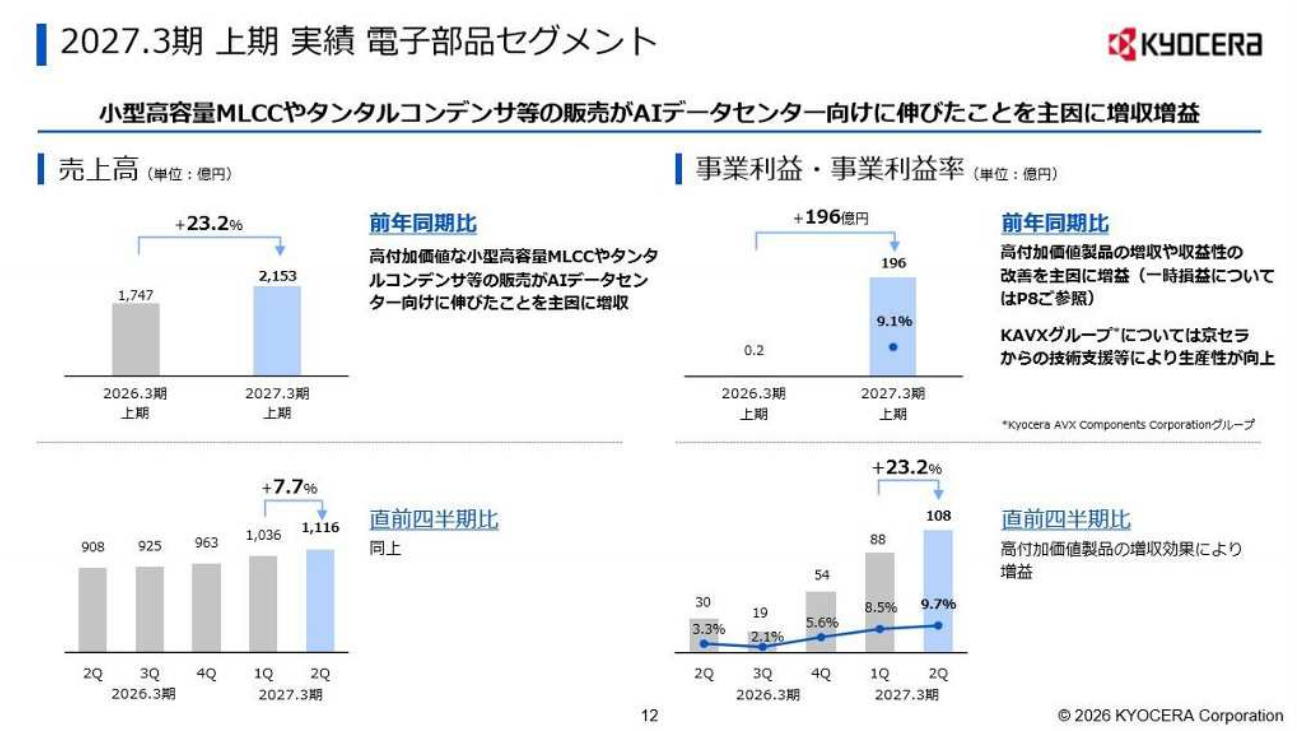
こちらはセグメント別利益の一覧です。

なお、ソリューションその他およびその他の事業には、先ほどご説明した一時損失の影響が含まれております。

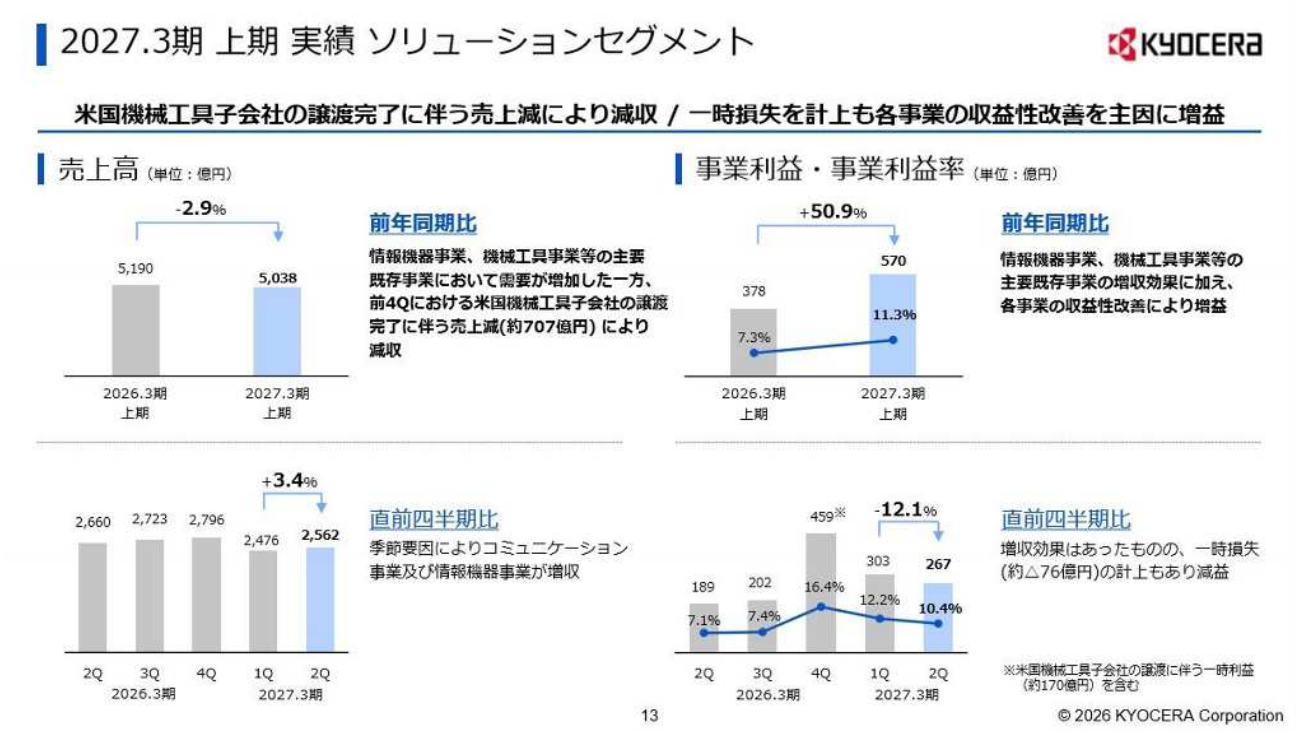


コアコンポーネントは、主に AI データセンター向け半導体パッケージおよび半導体製造装置向けファインセラミック部品の販売増を主因に、前年同期に比べ増収増益となりました。
また、これまで課題事業として構造改革を進めてきた半導体部品有機材料事業は、生産性向上により、2 桁の利益率を達成しております。

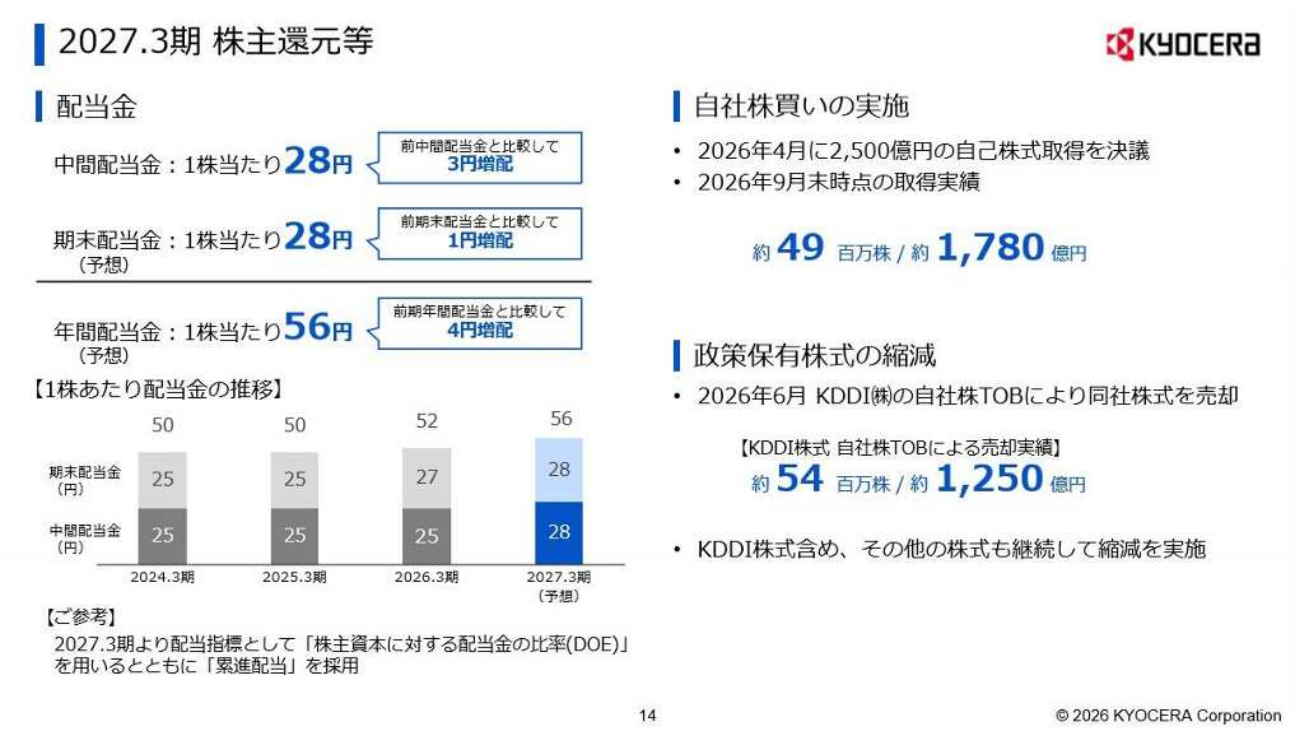
なお、当上期および当 2Q の売上高、事業利益の増減について、上段には前上期との比較、下段には当 1Q との比較を記載しておりますので、詳細はページ下部をご参照ください。



電子部品は、高付加価値な小型高容量 MLCC やタンタルコンデンサ等の販売が AI データセンター向けに伸びたことを主因に、前年同期に比べ増収増益となりました。KAVX グループについては、京セラからの技術支援等により、生産性が向上いたしました。



ソリューションは、米国機械工具子会社の譲渡完了に伴う売上減により、前年同期に比べ減収となりました。また、利益については一時損失の計上はあったものの、各事業の収益性改善を主因に増益となりました。



スライド左側の配当金をご覧ください。2027.3 期の中間配当金は、前中間配当金と比較して 1 株当たり 3 円増配の 28 円、期末配当金は 1 株当たり 1 円増配の 28 円を予想しており、年間配当金は前期の 52 円から 1 株当たり 4 円増配の 56 円を予定しております。

スライド右側に記載のとおり、自社株買いの実施については期初の計画どおり進捗中であり、2026 年 9 月末時点で約 4,900 万株、約 1,780 億円の自己株式取得を実施済みです。

また、政策保有株式の縮減についても期初の計画どおり進捗中で、本年 6 月に KDDI 株式会社の自社株 TOB に応募し、同社株式を売却したことにより、本年 9 月末時点で約 5,400 万株、約 1,250 億円の売却が完了しております。

2027.3期 業績予想

KYOCERA

(単位：百万円)

		2026.3期	2027.3期 前回予想(7月公表)	2027.3期 今回予想(11月公表)	増減金額 前期比	増減金額 前回予想比
売上高		2,070,203	2,080,000	2,120,000	49,797	40,000
営業利益		118,138 (5.7%)	160,000 (7.7%)	160,000 (7.5%)	41,862	—
税引前利益		168,994 (8.2%)	200,000 (9.6%)	200,000 (9.4%)	31,006	—
親会社の所有者に帰属する当期利益		140,969 (6.8%)	160,000 (7.7%)	160,000 (7.5%)	19,031	—
EPS(円)		102.70	122.04	123.62		
平均為替レート	米ドル	151円	155円	155円		
	ユーロ	175円	180円	180円		
設備投資額		149,099 (7.2%)	225,000 (10.8%)	225,000 (10.6%)	75,901	—
有形固定資産 減価償却費		110,924 (5.4%)	120,000 (5.8%)	120,000 (5.7%)	9,076	—
研究開発費		115,701 (5.6%)	120,000 (5.8%)	120,000 (5.7%)	4,299	—

* 2027.3期予想のEPSは、7月公表予想は2027.3期 第1四半期、11月公表予想は2027.3月期 上期の期中平均株式数を用いて算出。
( ) 内の数字は売上高比率

16

© 2026 KYOCERA Corporation

続いて、2027.3 期業績予想についてご説明いたします。

通期の業績予想につきましては、こちらの表に記載のとおり、本年 7 月の公表数値から売上高を 400 億円上方修正しています。そのほかの項目については変更ございません。

2027.3期 セグメント別売上高予想

KYOCERA

(単位：百万円)

	2026.3期		2027.3期				増減金額	
			前回予想(7月公表)		今回予想(11月公表)			
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期比	前回予想比
コアコンポーネント	653,429	31.6%	**716,000**	**34.4%**	**731,000**	**34.5%**	77,571	15,000
産業・車載用部品	250,069	12.1%	273,000	13.1%	273,000	12.9%	22,931	—
半導体関連部品	379,432	18.3%	415,000	20.0%	430,000	20.3%	50,568	15,000
その他	23,928	1.2%	28,000	1.3%	28,000	1.3%	4,072	—
電子部品	363,486	17.5%	**415,000**	**20.0%**	**430,000**	**20.3%**	66,514	15,000
ソリューション	1,070,919	51.7%	**964,800**	**46.4%**	**974,800**	**46.0%**	-96,119	10,000
機械工具	285,936	13.8%	180,000	8.6%	190,000	9.0%	-95,936	10,000
ドキュメントソリューション	478,479	23.1%	490,000	23.6%	490,000	23.1%	11,521	—
コミュニケーション	219,158	10.6%	200,000	9.6%	200,000	9.4%	-19,158	—
その他	87,346	4.2%	94,800	4.6%	94,800	4.5%	7,454	—
その他の事業	14,196	0.7%	15,000	0.7%	15,000	0.7%	804	—
調整及び消去	-31,827	-1.5%	-30,800	-1.5%	-30,800	-1.5%	1,027	—
売上高	2,070,203	100.0%	**2,080,000**	**100.0%**	**2,120,000**	**100.0%**	49,797	40,000

17

© 2026 KYOCERA Corporation

こちらはセグメント別売上高予想です。

売上高については、コアコンポーネント、電子部品をそれぞれ 150 億円、ソリューションを 100 億円、前回予想から上方修正しています。

2027.3期 セグメント別利益予想

KYOCERA

(単位：百万円)

	2026.3期		2027.3期 前回予想(7月公表)		2027.3期 今回予想(11月公表)		増減金額	
	金額	売上高比	金額	売上高比	金額	売上高比	前期比	前回予想比
コアコンポーネント	63,082	9.7%	**99,000**	**13.8%**	**112,000**	**15.3%**	48,918	13,000
産業・車載用部品	18,730	7.5%	36,000	13.2%	39,000	14.3%	20,270	3,000
半導体関連部品	46,933	12.4%	63,500	15.3%	73,500	17.1%	26,567	10,000 ※1
その他	-2,581	—	-500	—	-500	—	2,081	—
電子部品	7,316	2.0%	**26,000**	**6.3%**	**40,000**	**9.3%**	32,684	14,000
ソリューション	103,943	9.7%	**94,000**	**9.7%**	**99,000**	**10.2%**	-4,943	5,000
機械工具	35,196	12.3%	18,000	10.0%	25,000	13.2%	-10,196	7,000
ドキュメントソリューション	45,115	9.4%	47,000	9.6%	49,000	10.0%	3,885	2,000
コミュニケーション	12,116	5.5%	15,000	7.5%	18,000	9.0%	5,884	3,000
その他	11,516	13.2%	14,000	14.8%	7,000	7.4%	-4,516	-7,000 ※2
その他の事業	-21,742	—	-26,000	—	-58,000	—	-36,258	-32,000 ※3
事業利益　計	152,599	7.4%	**193,000**	**9.3%**	**193,000**	**9.1%**	40,401	—
本社部門損益等	16,395	—	7,000	—	7,000	—	-9,395	—
税引前利益	168,994	8.2%	**200,000**	**9.6%**	**200,000**	**9.4%**	31,006	—

※1 ケミカル事業譲渡に伴う一時利益 約+150億円を含む。
※2 エネルギー関連製品に係る引当金 約△76億円を含む。
※3 GaNデバイス事業 減損損失 約△295億円を含む。

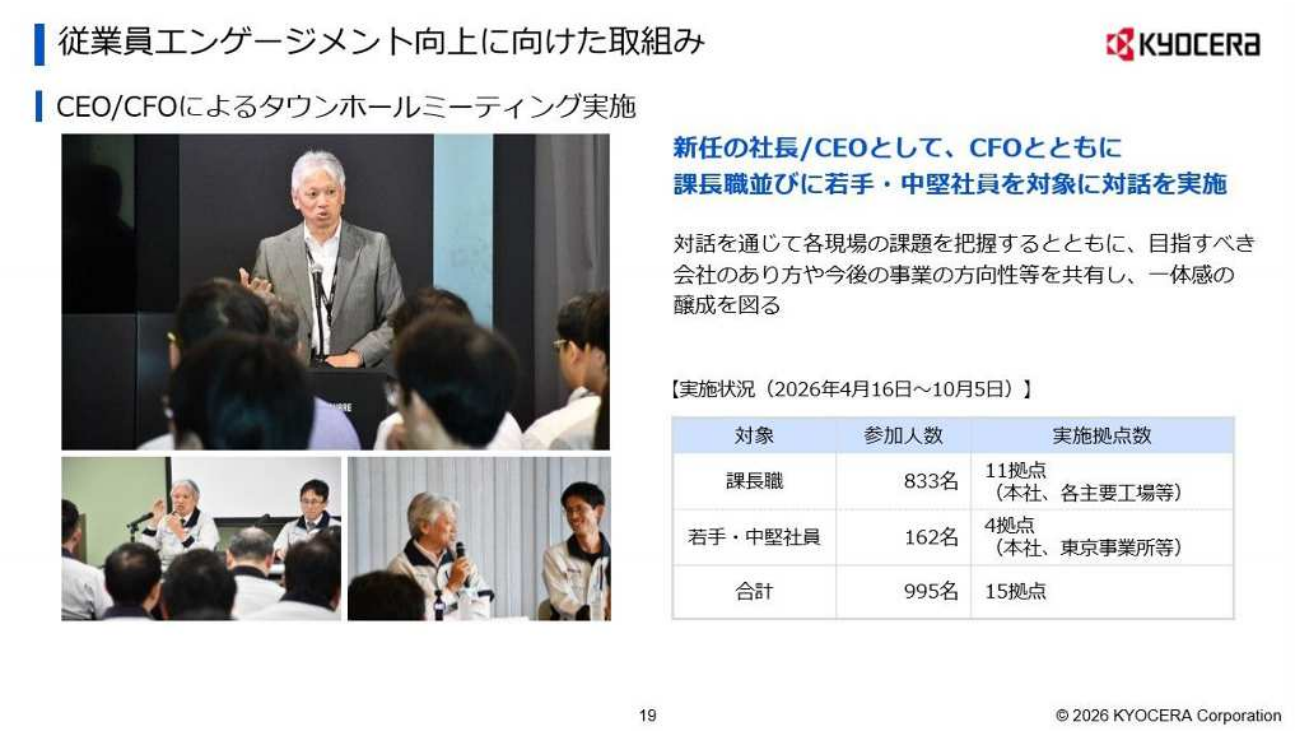
18

© 2026 KYOCERA Corporation

こちらはセグメント別利益の一覧です。

前回予想に対し、コアコンポーネントを 130 億円、電子部品を 140 億円、ソリューションを 50 億円上方修正した一方、その他の事業を 320 億円減額しています。

なお、コアコンポーネントの半導体関連部品にはケミカル事業譲渡に伴う一時利益約 150 億円、ソリューションのその他にはエネルギー関連製品に係る引当金約 76 億円、その他の事業には GaN デバイス事業における減損損失約 295 億円がそれぞれ含まれています。



こちらのスライドでは従業員エンゲージメント向上に向けた取り組みを記載しております。

私は本年 4 月に社長に就任して以来、新任の社長・CEO として、CFO の千田とともに、現場のリーダーであり、次世代を担う課長職ならびに若手・中堅社員を対象に対話を実施してまいりました。この対話を通じ、各現場の課題を把握するとともに、目指すべき会社のあり方や今後の事業の方向性等を共有し、一体感の醸成を図っております。10 月初旬までに合計 15 の拠点で延べ約 1,000 名と直接会い、対話を実施いたしました。今後も双方向のコミュニケーションを大切にし、従業員エンゲージメントのさらなる向上に努めてまいります。

当社は旺盛な部品需要を確実に業績拡大に結びつけるべく、引き続き注力製品の生産能力の拡大等に取り組んでまいります。

なお、すでにご案内しておりますとおり、中長期の事業戦略については、今月末に開催予定の説明会にてご説明する予定です。皆様のご参加をお待ちしております。

以上が私からの本日のご説明となります。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答

＜質問者 1＞

[Q]：半導体関連の営業利益が年間で 100 億円上方修正されていますが、ここにはケミカル事業の譲渡益 150 億円が含まれるため、実質的には少し下がっているかと思います。その背景を教えてください。

また、2027.3 期 下期については、一過性の要因を除いた場合には、もう少し生産増、稼働増等によって利益が上がる事業もあるかと思いますが、部品事業については上期と下期の利益水準がそれほど変わらないように見えます。そのあたりの背景を補足していただければと思います。

作島 [A]：半導体関連部品事業の利益に関しては、特にスマートフォン用のパッケージを上期に前倒しで納入したこともあり、上期の売上が増加しました。そのため、利益も上期は少し高く、下期は少し低めに見ておりますが、ケミカル事業の譲渡益計上により、こちらの利益減は相殺されると考えております。下期に半導体関連部品事業の利益が実質的に下がる主な要因は、スマートフォン用パッケージの前倒しと考えておりますが、現状の市況等を捉えれば、もう少し上げていけるのではないかと考えております。

[Q]：部品事業全体として、コアコンポーネント、電子部品で下期にもう少し上積みができそうな要素があるのはどこでしょうか。

作島 [A]：電子部品は来期に向けても非常に好調な引き合いをいただいておりますので、こちらは上期同様、もしくはそれ以上の実績が見込めるのではないかと見ております。半導体製造装置用部品についても、引き続き増産要求を受けている状況です。

[Q]：先ほど半導体関連部品事業でスマートフォン用のパッケージのお話をいただきましたが、有機パッケージは、元々の見通しに対して下期が上がるのではなく、変わらないのでしょうか。

作島 [A]：有機パッケージは、今のところ当社としても生産容量をフルに稼働させております。内部改善等で少し上げていきたいところですが、それほど極端に上がるわけではございません。

[Q]：期初に比べて見立てがかなり強くなり、一過性を除いたベースで見て、非常に強く、早く動いているところがあると思います。

元々、2028.3 期の目標 ROE5%を 2027.3 期に 1 年前倒しするというお話があり、一過性を除くとそのようになっていますが、2028.3 期の ROE の目線はどの程度になってきているのでしょうか。

さらに、その次の 2029.3 期から始まる 3 年間の目標 ROE は 8%でしたが、早めに 8%に達するのか、あるいは目標数値の 8%自体がもう少し上がるのか、どのように考え方が変わってきているのでしょうか。詳細は 11 月末の事業戦略説明会でご説明されるのかもしれませんが、大きな考え方、目線感をご紹介いただければありがたいです。

作島 [A]：本年 2 月に、2031.3 期の目標を ROE8%以上として進めていくとしました。直近の事業収益は、好調な市況に応じて、当初われわれが考えていたより上振れてきていると考えおり、ここを順調に上げていくことが必須だと考えています。

一方、分母についても、当初計画したとおりしっかり遂行していく必要がございます。8%の水準を 2031.3 期に達成することに関しては、しっかり取り組んでいきたいと考えています。

そのあたりのバランスは、分子を上げるスピードを速められるかどうかに関わってくると思いますので、その内容については、また今月末にご説明申し上げたいと思います。

[Q]：現時点では、8%というところに対して着実に進めようということが前提で、早く達成できるという見立てではないという理解ですか。それとも、11 月末までもう少し待ってほしいという意味で解釈してよろしいでしょうか。

作島 [A]：着実に 2031.3 期に 8%以上を目指すということです。前倒しもご期待いただいているかと思いますが、今のところ、そのような組み立てにはなっていないと考えています。

＜質問者 2＞

[Q]：コアコンポーネントの半導体関連部品の売上高が通期で 150 億円上方修正され、利益は 100 億円上方修正されていますが、ケミカル事業の譲渡益 150 億円を除くと 50 億円の減益です。

データセンター向けの光通信用パッケージなど、市況はずいぶん強いと思いますが、何が実質的な下方修正をもたらしているのか教えてください。

作島 [A]：上期の実績を踏まえ、先ほどのケミカルの事業譲渡も加味した上で、事業部門の直近の見立てを採用し、見通しを立てました。市況感等については大きく変化があるわけではございませんので、そのあたりは少し堅実に見ていると捉えていただいてよいかと思います。

[Q]：セラミックと有機に分けて考えた場合でも、どちらも堅調に推移しているということでよろしいですか。

作島 [A]：そのようにご理解いただければありがたいです。

[Q]：日本航空電子工業の株式 33%を取得して 1 年が経過しましたが、生産、販売面での
シナジーや協業の成果がどのように表れてきているのか、今後そのように表れてくるのかご教示
ください。

また、御社でも長年コネクタ事業を運営されてきましたが、1 年前に日本航空電子工業に 33%出資
してから、コネクタ産業に対する捉え方、見方がどのように変化してきているのか教えてくださ
い。

作島 [A]：シナジー等については、まだ具体的な協業がスタートしたばかりでございます。人的な
サポート等は計画どおり 2026.3 期末に行い、今、その活動を進めて、内部でのいろいろな改善に
寄与してくれているものと考えております。

一方、販売面の協業については、2027.3 期上期に、特に欧州における販売を京セラで担うという
ことで進めておりましたが、一部確認が必要なところも出ており、少し遅れております。確認が
必要な点はほぼ解消できそうですので、2026 年内にはその問題が解け、販売契約も締結でき、
来年の 1 月からスタートできるかと考えております。

製造部門の協業については、さらに 2028.3 期の前半に生産の体制を整える計画でございます。
シナジーの具体的な効果等はこれからになると考えておりますので、そのあたりをしっかり追いか
けていきたいと考えております。

また、コネクタ事業に対する捉え方ですが、コネクタは非常に大きな市場で、一部標準化された
部品等もある一方、カスタマイズ製のコネクタも数多くあり、その対応が、多くの会社が存在する
背景の一つです。このようなカスタム性の強いコネクタ商材を取り扱うことに関しては、京セラの
営業力等もございますので、今後、そのようなところを伸ばしていける素地になるのではないかと
考えています。

直近では、車載や産業機器等で少し苦戦等ありますが、今後、おそらくフィジカル AI 等でコネク
タの位置付けは変わってくるのではないかと考えております。そのあたりで協業の効果を発揮でき
るようなところを目指してまいりたいと考えております。

＜質問者 3＞

[Q]：2Q のソリューション事業について、特に機械工具やドキュメントソリューションの
利益率が非常に高くなっていると思いますが、どのようなことが起きているのでしょうか。

また、下期の見通しを拝見しますと、両事業とも、上期に対してかなり利益額が下がる前提になっています。保守的なご想定なのか、実質的な反動減を見ていらっしゃるのか、ご教示ください。

作島 [A]：機械工具については、タングステンの価格高騰が非常に顕著に出ており、われわれもお客様に価格転嫁をお願いしております。値上げのタイミング等のアナウンスに応じて、やはり駆け込み的に需要が急増する部分があり、この上期は機械工具でかなり売上が増加し、その結果として利益もついてきたところがございます。

下期には、特に原材料の高騰等の影響が表れてくると見ておりますので、機械工具については、下期は売上、利益ともに落ちるという見立てでございます。そのあたりは、上期と下期で少し変化を感じております。

それからドキュメントソリューションについては、特に 2026.3 期の上期は、欧州での販売にかなり苦戦したところがありましたが、2027.3 期はそのあたりが堅調に推移しました。また、2027.3 期においては一部関税の還付等もございましたので、上期は堅調な結果になっております。その分、下期は需要および利益を抑えたかたちになるのではないかと見ております。

部品事業と違い、ソリューション事業については、上期はメモリーの高騰等もございましたので、かなり前倒しで需要が先行しました。下期はそのあたりが少し抑え気味になるのではないかと考え、今回の通期見通しとしております。

[Q]：ドキュメントソリューションは特に 1Q から 2Q の変化を見ても、かなり変化が大きいと思いますが、何か一時的な押上げ要素等はあったのでしょうか。

作島 [A]：ドキュメントソリューションに関しては、売上等も上がっておりますが、米国の関税還付の影響が 2Q に出ている部分がございます。

[Q]：もし可能でしたら、おいくらくらいの影響が出たのか教えていただけますか。

作島 [A]：関税については、金額については非開示とさせていただきます。

[Q]：今回、減損損失を計上されていますが今後、追加的な減損リスクはどの程度見ておけばよいのでしょうか。

また、従前のご説明ですと、サザンカールソンの売却等を経て、御社の事業売却等は一段落したと認識していました。今後の事業ポートフォリオマネジメントはどのように考えればよろしいでしょうか。

作島 [A]：経営改革としては 2026.3 期から着手し、当初計画したものは予定どおり終了しておりますが、事業ポートフォリオの見直しは、既存事業だけでなく、新規事業や開発も含め、継続していくべきだと考えております。

今回、GaN デバイス事業で多額の損失を計上することになってしまいましたが、開発部門等で今抱えている事業計画等の見直しも、同じように俎上に乗せてしっかり判断していくことは継続して行いたいと考えております。そのような案件はいくつかございますので、しっかり見極め、適切に判断していきたいと考えております。

＜質問者 4＞

[Q]：ドキュメントソリューションについては、為替も変わっていますので、実態ベースで見たときに、1Q と 2Q で稼ぐ力に変化があったかどうかを教えてください。

機械工具に関しては、タングステンの値段が上がり、御社の事業部としても 12 月中旬に値上げをするというリリースを出されていると思います。御社のリサイクルは他社に比べて進んでいるのでしょうか。リサイクルをしたほうがかなりコストの競争力があると思いますので、進んでいるということであれば当然よいと思いますが、そこについての見方を教えてください。

また、他社はまだ値上げのリリースを出していないようであり、御社が早く出されたのかなという気がします。各社とも状況は変わらず、今後値上げになるような業界環境と理解すればよいのか教えてください。

作島 [A]：機械工具について、12 月の値上げをお知らせしていますが、弊社は段階的に値上げを実施しており、2027.3 期はこれが 2 度目になると思います。2026.3 期末にも一度値上げを実施しておりますので、3 段階で値上げを進めております。

この動きについては弊社だけではなく、他社さんも値上げを進められております。それぞれの製品特徴に合わせて、値上げ幅にはばらつきがありますが、基本的にはわれわれだけではなく、業界全体で値段が上がっているのが今の実情かと感じます。

中国ではタングステンの価格が少し下がってきているので、中国市場は別ですが、そのほかの地域については、そのような状況とご理解いただければと考えます。決して弊社だけが値上げしている状況ではございません。

また、リサイクルについては、先ほど発表した内容は 2031.3 期に向けての話ですので、まだ実際に業績に寄与するわけではございません。ただ、以前よりそのような懸念に対して研究開発を進めていたこともあり、今回、本格的に投資をすると判断した次第でございます。

リサイクルについては、われわれ自身で材料そのものをリサイクルすることは、これまでできておりませんでしたが、例えばスクラップの部材等を入手した際には、業者さんにお願いしてリサイクルしてもらうことは、これまでも実施しておりました。

今、タングステンの値段も非常に高く、入手もしにくい中で注目されているところですので、この取り組みは活性化していくべきだと考えております。

ソリューションの 1Q、2Q 稼ぐ力の変化については、千田から回答いたします。

千田 [A]：ドキュメントソリューションについては、1Q と 2Q を比較したときに、ユーロに対して円高になっていますが、為替の影響を除けば、稼ぐ力はそれほど変わっておりません。

作島が申し上げたとおり、関税等の一時的な収益が入っているため利益率が 1Q から 2Q で 5%程上昇したように見えていますが、稼ぐ力としては、1Q と 2Q でそれほど変化はありません。

[Q]：電子部品については、1Q に一時利益があり、利益率の改善がかなり遅れたというのがご実績だったのに対し、2Q はかなり良くなっていらっしゃいます。

これは、売上の伸び以上に利益が改善したということだと思います。製品のどこが良くなり、どのような効果が出てきたのか、改善した背景を教えていただけないでしょうか。

作島 [A]：改善のメインは、やはり MLCC とタンタルコンデンサになります。両製品とも生産性が悪く、歩留まり等にも課題がある状況でしたが、京セラのエンジニアがそこに入り、原価の分析や、生産効率の課題、歩留まりの課題等について、かなり緻密に中身を分析し、そのための手立てを数年前から打ってまいりました。それが具体的にようやく数字として表れてきました。

また、これらの製品も当然、材料等の高騰がございますので、ある程度値上げを進めていることも改善の要因かと思います。それらが特に 2Q に顕著に出てきたのではないかと分析しております。

＜質問者 5＞

[Q]：データセンター周辺の製品群は、SPE 向けのセラミックス部品等も合わせると、構成比がかなり上がってきているのではないかと思います。現在の構成比などの数字があれば教えていただきたいです。

また、御社の各製品のマーケットにおける立ち位置をどのようにお考えかを教えてください。MLCC 等もかなり好調になっており、御社の製品の需要も増えてきているのではないかと思います。シェアが上がっているのか、採用がどのように増えているのか等、データセンターの全体感について教えていただければと思います。

作島 [A]：データセンター周辺の製品群の構成比については、11 月末の説明会にてあらためてお示しします。

半導体製造装置向けファインセラミック部品については、従前よりわれわれが非常に高いシェアを有しているので、堅調に進んでおります。一部他社とシェアを分け合っているエッチャー用の静電チャック等については、シェアを上げていくべく、いろいろな取り組みを行っており、新たな開発品もここに展開しようとしております。ですので、既存のシェアを持っているところは、数量とシェアをしっかり維持するとともに、シェアの比較的弱かったところはケアして上げていきます。

セラミックパッケージについては従前より非常に高いシェアを有しておりますので、現在の引き合いにしっかり対応することで伸ばしていきます。

MLCC については、実際の所要が上がっていることで、数量が上がっていることは間違いございませんが、他社も含めて大きな投資、あるいは非常に堅調な引き合いがあると考えておりますので、シェアそのものはそれほど大きくは変わっていないのではないかと思います。ただ、われわれは全方位的ではなく、AI データセンター向けの小型高容量の製品と、これからメインで使われる比較的難易度の高い製品に注力しており、そこのシェアはしっかり負けずに獲得できるよう取り組んでいきたいと考えております。

いずれも、このあたりについては現時点で堅調に推移しております。先ほど申しました半導体製造装置用部品、半導体パッケージ、電子部品のうち、前者二つは従前より強い製品ですので、着実に伸ばしてまいります。MLCC については、われわれはチャレンジャーと考えておりますので、新しい所要に対する価値提供をしっかり行うことで、売上、利益を伸ばしていきたいと考えております。

[Q]：データセンター向けのセラミックパッケージについては、トランシーバー向けのセラミックパッケージのシェアが高いという理解で合っていますか。

作島 [A]：はい。光通信用のパッケージは非常にシェアが高くなっています。

[Q]：従前は、設備投資は 2027.3 期がピークで、2028.3 期は 500 億円弱下がるというご計画だったと思います。現状の非常に活況な需要等を受けて、設備投資の水準を一段と上げていかれる可能性等はあるのか教えてください。

作島 [A]：期初にはそのような計画であるとお話ししましたが、その後のお客様からのご要求等は非常に強いものがございます。前回の内容から少し上げていかなければならないと考えておりますので、上げていく方向でご説明することになると思います。

以上

注記
当資料は、SCRIPTS Asia株式会社によって録音・書き起こしされたものを当社にて一部編集したものです。

将来事象に関する注意事項 当資料には、将来の事象についての 2027 年 3 月期 上期 決算説明会開催日（2026 年 11 月 2 日開催）時点における当社グループの期待、見積り及び予測に基づく記述が含まれています。これらの将来の事象についての記述には、既知及び未知のリスク、不確実な要因並びにその他の要因が内包されており、当社グループの将来における実際の財政状態及び活動状況が、当該将来の事象についての記述によって明示または黙示されているところと大きく異なる場合があります。詳細は、当社ホームページに掲載の「将来の見通しに関する記述等について」をご参照ください（https://www.kyocera.co.jp/ir/disclaimer.html）。